

AOI y AXI para uniones wire bonding y otros aspectos de inspección

El sistema de inspección X7056-II BO combina los controles ópticos en línea de uniones wire bonding con eficacia con la inspección automática de rayos X. Este concepto integral de inspección permite alcanzar una eficiencia superior, tiempos de ciclo inmejorables y un rendimiento excelente. Además, el precio de compra es mucho más bajo que al adquirir dos sistemas de inspección por separado.

El software de inspección de Viscom ha sido diseñado para alcanzar la profundidad máxima de inspección y precisión. Se dispone de muestras de inspección en la biblioteca estándar para las uniones de chips, las uniones de bola-hilo, hilo-hilo y de seguridad. El volumen de inspección se puede ampliar de forma personalizada. La tecnología de sensores ópticos de alta resolución capturan todos los puntos e hilos de soldadura durante la inspección. La inspección automática en línea por rayos X se conecta fácilmente. Entre otras opciones, se comprueba la calidad de los cursos de las uniones, las uniones y la posición de los componentes. Por tanto, no tiene importancia si las conexiones son de cobre, aluminio u oro, y si se trata de cintas, uniones gruesas o estrechas. Se detectan deterioros y desviaciones de posición de componentes de seguridad.

Viscom también ofrece verificación, programación fuera de línea y evaluación SPC integrales y eficientes.

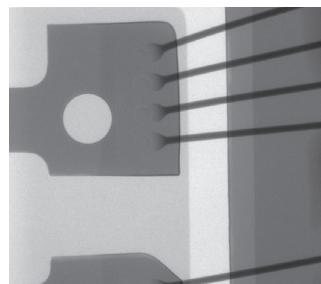
Unión AOI y AXI combinada en un sistema

Software eficiente de inspección de Viscom

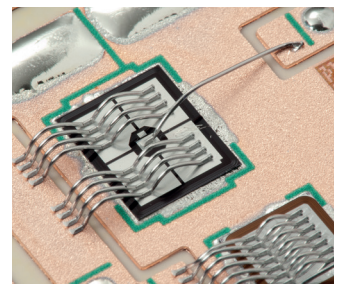
Precisión muy alta y profundidad de inspección

Selección flexible de módulos de cámara para uniones con hilos gruesos y finos

Tubo de rayos X cerrado y libre de mantenimiento microfoco



Inspección de fijación de hilos en radiografías



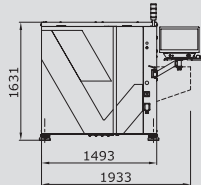
Reconocimiento de errores en conexiones multi-únión y multi-bucles

Bond

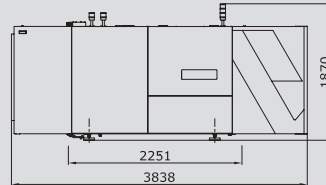
Datos técnicos



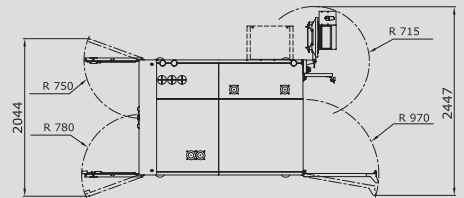
Vista frontal



Vista lateral



Vista superior



Expresado en mm

		X7056-II BO
Tecnología de rayos X	Tubos de rayos X	Tubo de rayos X cerrado
	Alta tensión	60 - 130 kV
	Intensidad del tubo	50 - 300 μ A
	Detector	Detector de panel plano (FPD), profundidad de color de 14 bits
	Resolución	6 - 30 μ m/píxel (depende de la configuración)
	Cabina de rayos X	Diseñada según los requisitos para las cabinas de protección total en conformidad con la ley alemana (StrlSchG) y el decreto sobre la protección radiológica (StrlSchV). Relación de pérdida de radiación < 1 μ Sv/h
Tecnología de sensores*	Módulo HR de unión XM – cámara ortogonal	
	Tamaño de campo de imagen	23 mm x 23 mm
	Resolución	4,5 μ m
	Número de cámaras de megapíxeles	1
Software	Interfaz de usuario	EasyPro/vVision-ready de Viscom
	Estación de verificación	HARAN de Viscom
	SPC	SPC de Viscom (control estadístico de procesos), interfaz abierta (opcional)
	Diagnóstico remoto	SRC de Viscom (Software Remote Control) (opcional)
	Programación fuera de línea	Viscom PST34 (estación de programación externa) (opcional)
	Análisis sistemáticos de errores e inspección continua del sistema	Viscom PDC (Process Data Control), TCM (Technical Chain Management)
Ordenador del sistema	Sistema operativo	Windows®
	Procesador	Intel® Core™ i7
Manejo de sustratos	Dimensiones del sustrato	Hasta 450 x 350 mm (longitud x ancho)
	Altura de transferencia	850 - 980 mm \pm 20 mm
	Fijación de sustrato	Neumática
	Ancho de capa de sustrato	3 mm
	Altura de paso superior	Hasta 25 mm; FPD con resolución de 8 μ m: 20 mm
	Altura de paso inferior	50 mm
Otros datos del sistema	Unidad de posicionamiento	Motores lineales síncronos
	Interfaces	SMEMA, SV70, según los requerimientos del cliente
	Conexión eléctrica	400 V (otras tensiones bajo demanda), 3P/N/PE, 8 A, presión de trabajo 4-8 bar
	Dimensiones del sistema	1493 mm x 1631 mm x 2251 mm (anchura x altura x profundidad)
	Dimensión de integración de línea	+25 mm
	Peso	2245 kg

*Otros módulos de cámara bajo demanda.